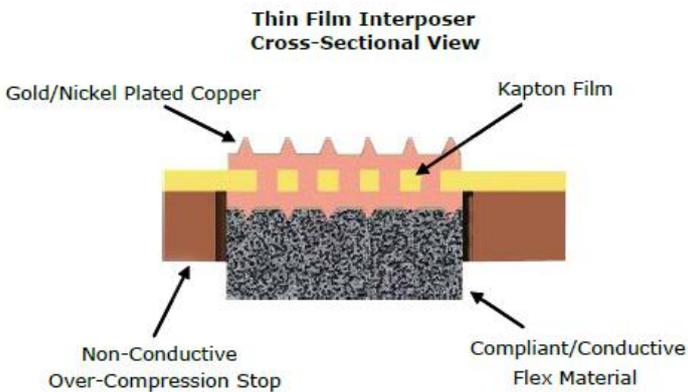


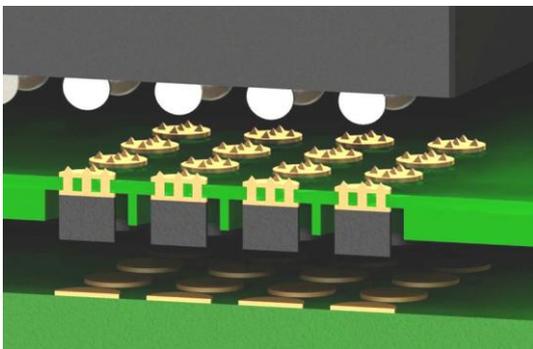
**產品介紹**

薄膜中介片技術是傳統探針技術外的另一項選擇，  
 它能在晶片和測試設備之間產生電路的暫時透明連接。  
 採用迷你導電彈性體，形成非常短的電流路線，  
 具有低電阻，和超低電感值和電容值等優點，  
 並且**施加力道 Force 低，不造成被測物之損傷。**  
 以傳遞最清晰的影像。此技術對於高頻率和**高電流**之產品使用效果特別好!

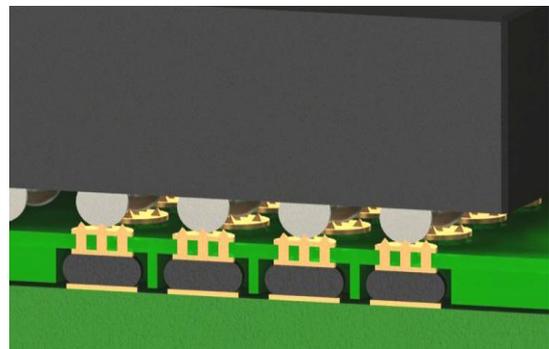
**設計原理 與 優異的電氣特性:**



Specifications:	
Current Carrying Capabilities	>5 Amps per pin
Environmental	-40 C to 155 C
Typical Contact Force	15-25 grams per pin
Electrical Contact	<0.012" to .016"
Contact Compliance	<.003" to 0.005"



壓縮前



壓縮後

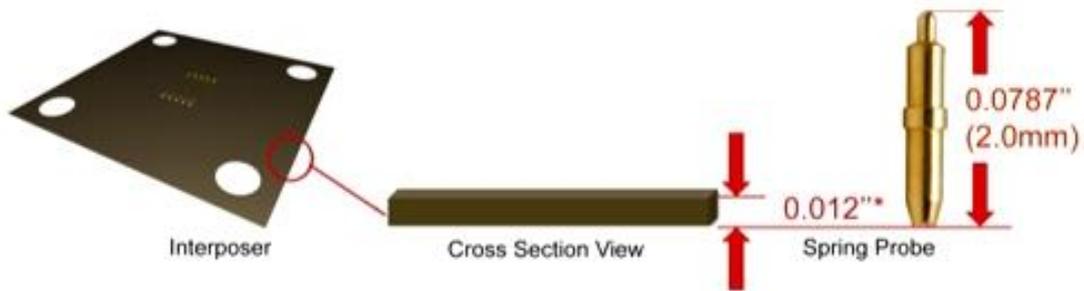
中介片為何與眾不同?

與加工而成的彈簧探針不同的製造技術，中介片採光蝕技術製造。

經由印製程序，接觸點能以最精密間距生產，小至 0.2mm pitch。

因其超薄外型設計，中介片可呈現最優良的電氣效能。

並可廣泛應用於各式各樣的設計，包括混和的間距及特殊規格的要求。



中介片之應用:

1. TPM FPC Test Connector

眾多標準品項 Pitch : 0.2~1.0mm ; Pin number : 4~93pin ; 3 種輸出接頭。



FFC Type



PCB Type



FRC Type

2. IC Final Test Socket

使用 Interposer 取代 Probe(Pogo pin)。  
All customized。

